

TS CR RMA

FLUXO DE SOLDA RESINOSO TIPO RMA

(Fluxos Resinosos Mediamente Ativados (RMA))

Informações Gerais

Fluxo resinoso classificado tipo ROL1 sob o padrão IPC ANSI/J-STD-004 da Joint Industry Standard. Sob o padrão MIL-F-14256, estes fluxos foram aprovados pela QPL como Tipo RMA. Embora a habilidade deste fluxo seja muito parecida com as dos fluxos RA, o resíduo de fluxo após a solda é não-corrosivo e não-condutivo. Desenvolvido para aplicações críticas onde montagens difíceis devam ser soldadas, e exigências de processo estipulam o uso de fluxo Tipo RMA.

Possui alta estabilidade térmica para soldar placas que necessitem de alta temperatura de pré-aquecimento. A exposição a altas temperaturas de pré-aquecimento não degrada a solubilidade do resíduo em solventes normais de limpeza.

Não há nenhuma perda na resistência de isolamento superficial causada pelo resíduo de fluxo. O uso de um mínimo de agentes iônicos ativados e a natureza inativa do resíduo permite deixar o resíduo nas placas para muitas aplicações. O resíduo de fluxo também é resistente à umidade e a fungos.

Quando desejado ou requerido pela especificação do processo, o resíduo de fluxo pode ser completamente removido usando qualquer saponífero, aquoso ou semi-aquoso. Um excelente grau de limpeza visual e iônica é atingido em montagens passadas por este processo.

Este fluxo foi projetado para soldagem automatizada por onda ou por arrasto para placas face simples, dupla-face e multi-layers. Fórmula padrão para muitas aplicações. Ela possui a mais alta atividade e é particularmente aplicável para placas multi-layer. Aplicáveis para circuitos SMT soldados por onda, a fórmula deixa a menor quantidade de resíduo após a solda.

Aplicação

Este fluxo é desenvolvido para uso em equipamento de fluxagem por espuma. Uma lâmina estável e uniforme de pequenas bolhas será produzida. Filtros e coletores devem ser usados para assegurar uma própria ação espumante prevenindo a sujeira e água de entrar no tanque de fluxo e reduzir sua efetividade.

A gravidade específica do fluxo deve ser conferida a intervalos regulares e a adição de quantia apropriada de Thinner #120 para substituir perdas por evaporação é altamente recomendada.

Características

- ◆ Resíduo por soldagem quase incolor
- ◆ Melhora o aspecto de soldagem
- ◆ Resíduos não condutivos e não corrosivos são eliminados,
- ◆ Redução do odor associado ao processo de soldagem
- ◆ Frente de onda de espuma uniforme e estável no equipamento de fluxagem
- ◆ Conforme a especificação Bellcore TR-NWT-000078 (emissão 3/12/1991)

Armazenamento

Estes fluxos são inflamáveis. Armazenar longe de fontes de ignição.

Propriedades Físicas

	RMA
Gravidade Específica@ (24°C) 75°F	0.879 ± 0.005
Percentual Sólido	36
Flash point (T.O.C.)	64°F (18°C)
Resistividade da água ohm-cm (típico)	125,000
Teste corrosão - Copper mirror	Pass
Teste de Papel Cromatos de Prata para haletos.	Pass
Teste para fluorados	Não-detetado
Resistência de Isolamento da superfície (típica) @ 85°C, umidade rel. 85%	5x10 ¹⁰ ohm
Fator Espalhamento de solda, mm	95
Percentual de Haletos Livres	<0.03
Thinner	#120

Saúde e Segurança

Este produto, durante manuseio ou uso, pode ser prejudicial à saúde ou ao ambiente. Leia a Folha de Dados de Segurança do Produto (MSDS) e rótulos de alerta antes de utilizar este produto.